

テーマ名： スパッタリング法について

技術相談内容： (質問事項)	金属薄膜を成膜するスパッタリング方法について教えてほしい。	
技術 相談 区分	関連製品品目：	
	関連技術分野：	
	キーワード：	薄膜，スパッタリング

回答内容：	代表的な成膜方法として、真空蒸着法及びスパッタリング法について説明するとともに、スパッタリング法の特徴である ・ 膜と基板の付着力が大きい。 ・ レートの設定がしやすく膜厚制御が容易である。 ・ 量産向きの成膜法である。 等の特性を理解していただき、実際にスパッタリング実験を行い、体験を通して体得していただいた。	
回答 担当 者	所属部所名：	機械電子部
	職 氏 名：	研究員 池田 哲
	E-mail：	ikeda@oita-ri.go.jp